

ルネサス SRAM製品 アウトライン

2024.04.17版

ルネサス エレクトロニクス株式会社
アナログ&コネクティビティプロダクトグループ
汎用製品事業部 汎用製品部
汎用メモリ製品課

SRAM-2024-J-0417-1

メモリ製品ポートフォリオ

■ “One-Renesas” として 様々なアプリケーションに最適のメモリソリューションを提供します

Memory Types	Products	Sources
低消費電力SRAM	<ul style="list-style-type: none"> ■ (5V, 3V) 256Kb, 1Mb, 4Mb ■ (3V) 2Mb, 8Mb, 16Mb, 32Mb, 64Mb 	Renesas
非同期型 高速SRAM	<ul style="list-style-type: none"> ■ (5V, 3.3V) 4Mb ■ (5V) 16Kb, 64Kb, 256Kb ■ (5V, 3.3V) 1Mb ■ (3.3V) 4Mb 	
同期型 超高速SRAM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pipeline Burst / Flow-through : 4Mb, 9Mb ■ Zero Bus Turnaround (ZBT) : 4Mb, 9Mb, 18Mb 	former IDT
特殊メモリ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Multi-Port (5V, 3.3V, 2.5V) 8Kb ~ 36Mb ■ FIFO (5V, 3.3V, 2.5V) 2Kb ~ 9Mb 	
EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Serial I/F: I2C, SPI (1.8V ~ 5.5V) 2Kb ~ 512Kb 	Renesas
SPI NOR Flash	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standard Products: (1.8V) 8Mb ~ 128Mb (3V) 256Kb ~ 128Mb (1.8 ~ 3V, Wide Vcc) 256Kb ~ 32Mb ■ System-Enhancing Products: Fusion / FusionHD 512Kb~32Mb / DataFlash 2Mb~64Mb / Ultra-Low Energy 1Mb~4Mb 	former Dialog

本資料にて
ご紹介

ルネサス 汎用SRAM 概要

信頼性に優れた市場実績豊富なSRAM製品

■ 高信頼性

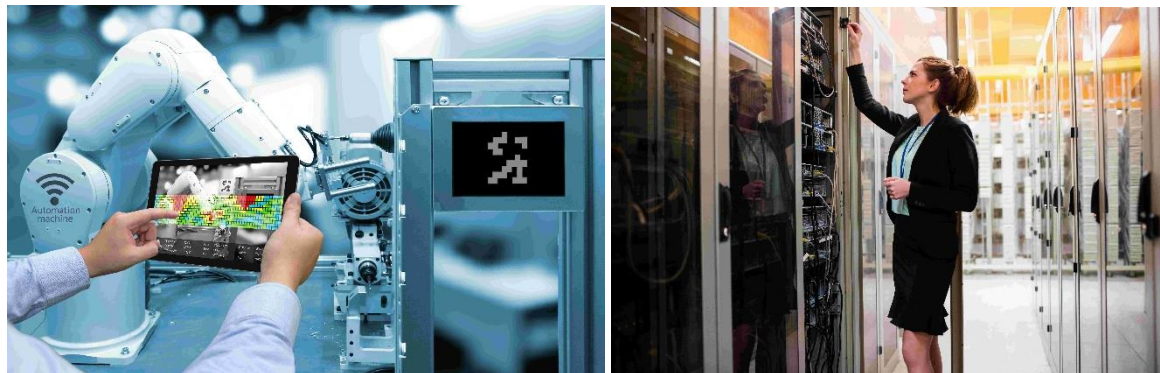
- ECC内蔵不要の卓越したソフトエラー耐性
- ラッチアップの発生しないメモリセル構造

■ 長期安定供給

- 長期製品供給プログラム (PLP) 対応

■ 豊富なラインアップ

- 256Kbから 業界最大容量64Mbまで
すべてがソフトエラー対策製品
- 根強い要求のある電源電圧5V品の継続対応
- 容量互換性のある多彩なパッケージ展開



■ 用途・採用実績

■ 一般産業

- FA機器(PLC, CNC 等), サーボモータ, AC駆動(インバータ), 産業用ロボット, プラント制御システム, 自動販売機, 自動改札機, 銀行ATM, etc.

■ 通信機器

- ルーター, 交換機, 基地局装置, etc.

■ 社会インフラ

- エレベータ, 輸送システム, 鉄道システム, 交通信号システム, スマートグリッド機器, etc.

■ 医療・ヘルスケア

- 医療用電子機器, etc.

■ OA機器

- 多機能プリンタ (複合機) , etc.

■ 民生機器

- アミューズメント機器, 電子楽器, 電卓, etc.

■ 車載アクセサリ (非駆動系機器)

- ETC関連機器, デジタルタコメーター, etc.



ルネサス 汎用SRAM ロードマップ

■ 256Kb から64Mbまで、幅広いラインアップで長期安定供給中です

■ ロードマップ



量産中



開発中

SRAM Type	容量 (電源電圧)	~2023	2024	2025	2026	2027	2028~
低消費電力 SRAM	256Kb, 1Mb (5V/3V) 2Mb (3V) 4Mb (5V)	0.15 μ m Advanced LPSRAM					
	4Mb (3V) 8Mb, 16Mb (3V) 32Mb, 64Mb (3V)	0.11 μ m Advanced LPSRAM					
	16Mb (3V) R1LV1616Hシリーズ <EOL品>	0.13 μ m (ECC内蔵)					
	16Mb (3V) RMLV1616A-Uシリーズ <R1LV1616Hシリーズ後継品>		MP: NOW	0.11 μ m Advanced LPSRAM			
非同期 高速SRAM	4Mb (5V/3V)	0.18 μ m CMOS					

2024年4月現在

R1LV1616Hシリーズ後継製品 RMLV1616A-Uシリーズ

新製品・量産中
お問い合わせください

■ Drop-in互換のスピード、低消費電力、パッケージ / ソフトエラー耐性はさらに向上！

項目	R1LV1616H series <EOL品>	RMLV1616A-U series <後継製品>	☑ Drop-in 互換性 & 特記
アクセス時間	45ns / 55ns	45ns / 55ns	☑ 45ns品サポート
スタンバイ電流	0.5μA (typ.) / 8μA (max.)	0.5μA (typ.) / 8μA (max.)	☑ 8μA, max. サポート
パッケージ	48-ball FBGA (8.0x9.5mm ²)	48-ball FBGA (7.5x8.5 mm ²)	☑ 同一ballピッチ & ピン配置
	48-pin TSOP (I)	48-pin TSOP (I)	☑ 同一外形 & ピン配置
ソフトエラー対策 (具体的手段)	あり (ECC内蔵)	あり (Advanced LPSRAM技術)	☑ Advanced LPSRAMについては、 こちら をご参照ください
ソフトエラー発生率 (実測値)	< 5.5 FIT/Mb	< 0.04 FIT/Mb	☑ ECC内蔵SRAMよりも優秀です！ 詳細はお問合せください

16Mb低消費電力SRAMラインアップ

Wafer Process	Density	Catalog Part Name	Orderable Part Name	Package (pinout)	Packing Type	Access Time	Standby Current (typ. / max.)	Operating Voltage	Operating Temperature	PLP period
RMLV1616A-U series 新製品	16Mbit	RMLV1616AGBG-4U2	RMLV1616AGBG-4U2#AC0	FBGA (48)	Tray	45ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032 予定 (注)
			RMLV1616AGBG-4U2#KC0	FBGA (48)	Tape & Reel	45ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
		RMLV1616AGBG-5U2	RMLV1616AGBG-5U2#AC0	FBGA (48)	Tray	55ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
			RMLV1616AGBG-5U2#KC0	FBGA (48)	Tape & Reel	55ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
0.11μm Advanced	16Mbit	RMLV1616AGSA-4U2	RMLV1616AGSA-4U2#AA0	TSOP-I (48)	Tray	45ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
			RMLV1616AGSA-4U2#KA0	TSOP-I (48)	Tape & Reel	45ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
		RMLV1616AGSA-5U2	RMLV1616AGSA-5U2#AA0	TSOP-I (48)	Tray	55ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
			RMLV1616AGSA-5U2#KA0	TSOP-I (48)	Tape & Reel	55ns	0.4μA / 8μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	
RMLV1616A-S series 量産中	16Mbit	RMLV1616AGBG-5S2	RMLV1616AGBG-5S2#AC0	FBGA (48)	Tray	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032
			RMLV1616AGBG-5S2#KC0	FBGA (48)	Tape & Reel	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032
0.11μm Advanced	16Mbit	RMLV1616AGSA-5S2	RMLV1616AGSA-5S2#AA0	TSOP-I (48)	Tray	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032
			RMLV1616AGSA-5S2#KA0	TSOP-I (48)	Tape & Reel	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032
		RMLV1616AGSD-5S2	RMLV1616AGSD-5S2#AA1	μTSOP (52)	Tray	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032
			RMLV1616AGSD-5S2#HA1	μTSOP (52)	Tape & Reel	55ns	0.5μA / 16μA	2.7V ~ 3.6V	-40 ~ 85 °C	Dec. 2032

注：RMLV1616A-Uシリーズは、他製品と同じPLP適用期間を登録予定です。

チップシュリンクと低消費電力化を両立 32Mb/64Mb 製品仕様

量産中

■ 単なる世代交代でなく、消費電力の大幅低減による付加価値を提供します

		0.15μm プロセス	0.11μm プロセス		
32Mb FBGA (48) TSOP-I (48) μTSOP (52)	製品ファミリ		R1LV3216R series	RMLV3216A series	
	アクセス時間	tAA	55ns	55ns	
	動作電流	Icc1	55mA (Max.)	35mA (Max.)	動作電流 36%低減!
	スタンバイ電流	ISB1	4μA (Typ.)@25°C 80μA (Max.)@85°C	0.6μA (Typ.)@25°C 24μA (Max.)@85°C	スタンバイ電流 85%低減!
	データ保持電圧	VDR	2.0V	1.5V	
64Mb (MCP:32Mb x2) FBGA (48) TSOP-I (48) μTSOP (52)	製品ファミリ		R1WV6416R series	RMWV6416A series	
	アクセス時間	tAA	55ns	55ns	
	動作電流	Icc1	60mA (Max.)	38mA (Max.)	動作電流 36%低減!
	スタンバイ電流	ISB1	8μA (Typ.)@25°C 160μA (Max.)@85°C	1.2μA (Typ.)@25°C 46μA (Max.)@85°C	スタンバイ電流 85%低減!
	データ保持電圧	VDR	2.0V	1.5V	

基本的な回路構成

SRAM バッテリーバックアップ

不揮発RAM (NVRAM) を構成し、電源遮断時にもデータを保持する用途

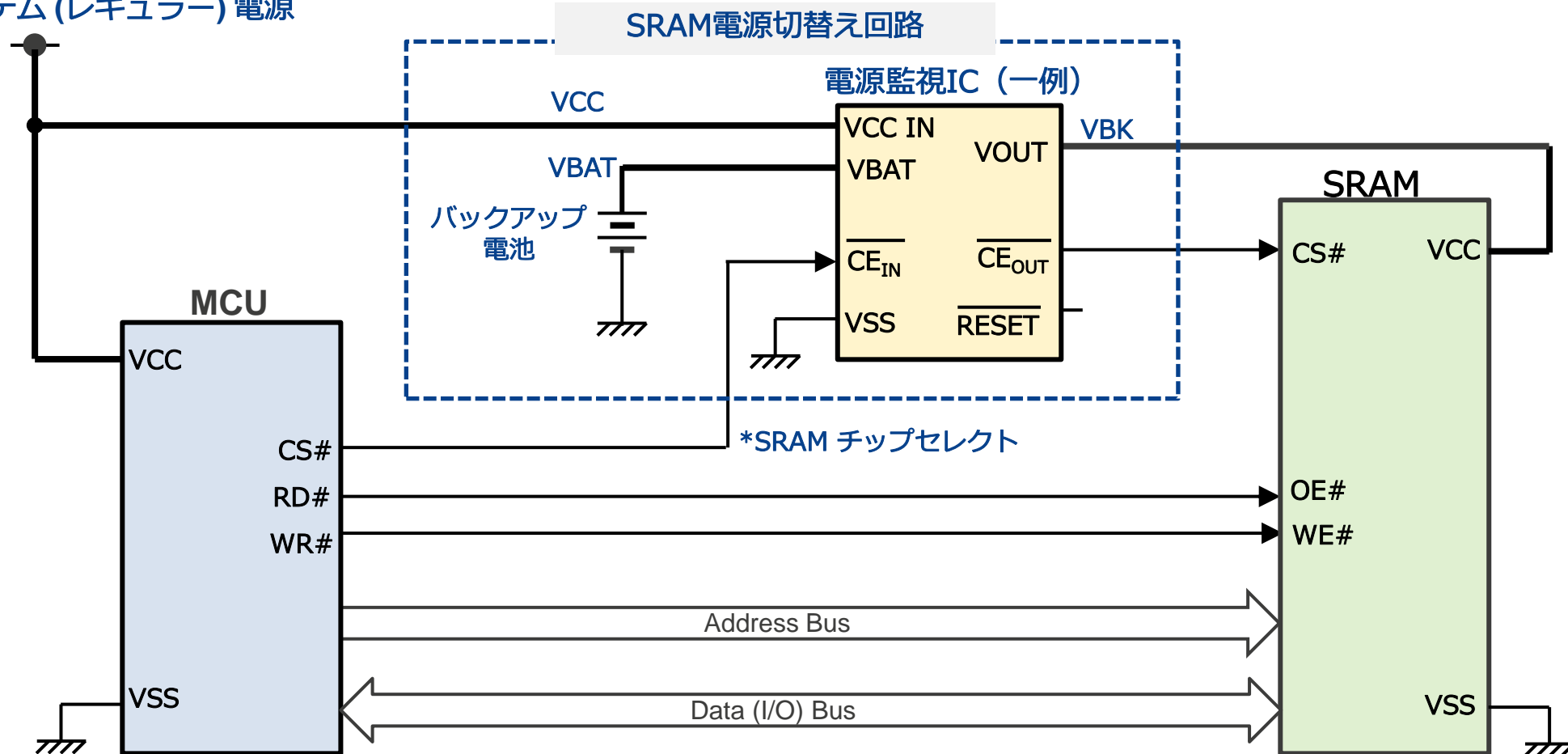
- ・低スタンバイ電流 = 電池の長寿命化に寄与
- ・低ソフトエラー発生率 = 長期データ保持への信頼度

[SRAM FAQ](#) で詳細な設計ガイドをご覧ください

[SRAMバッテリーバックアップ回路の設計 \(推奨される使い方\)](#)

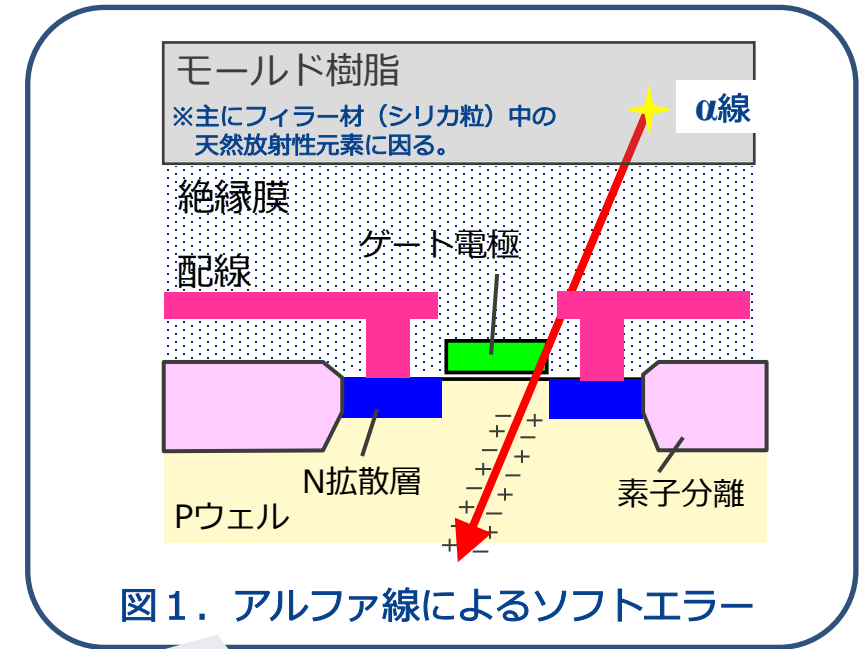
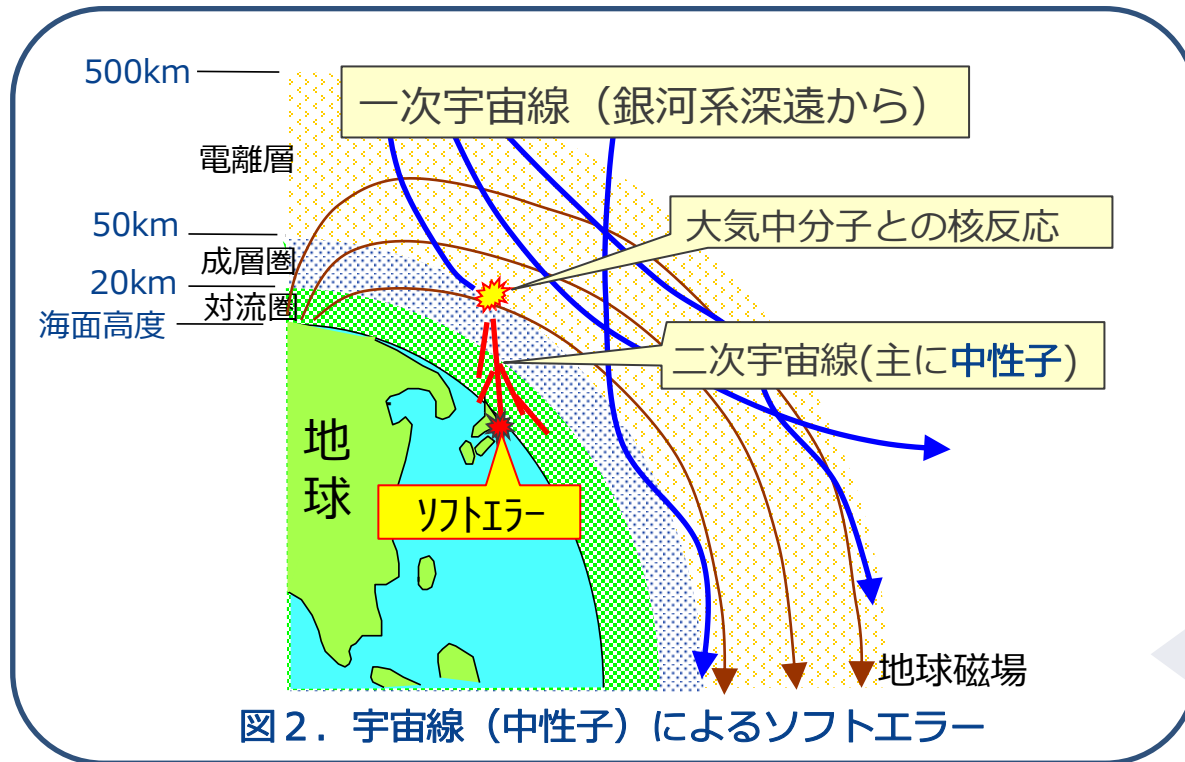
[SRAMバッテリーバックアップ回路の注意点 \(推奨されない使い方\)](#)

システム (レギュラー) 電源



技術的課題：ソフトエラーについて

1. メモリの内容が、ごくまれにビット反転を起こし不良として顕在化する現象。別にSingle Event Upset (SEU) とも呼ばれる。
2. 恒久的なハード不良ではなく、MCU側から正しいデータに書き直すことができる。



3. '90年代初め頃までは、半導体パッケージ材料にごく微量に含まれる、放射性同位元素から発生するアルファ線 (α線) が主因とされた。(図1)
4. '90年代以降、半導体デバイスのプロセスルールが0.1μm (100nm)以下に微細化されてくると、地球外から降り注ぐ宇宙線起因の高エネルギー粒子、特に中性子によるソフトエラーが顕在化。(図2)

他社製品との差別化

■ 256Kbから64Mbまで 全ての低消費電力SRAMがソフトエラーフリー！

ソフトエラー対策？

YES

NO

✓ 量産中

Supplier	Process	256Kb	1Mb	2Mb	4Mb	8Mb	16Mb	32Mb	64Mb	Remarks
ルネサス LP-SRAM	0.15μm Advanced	✓	✓	✓	✓ (5V品)	0.11μm Advancedへ世代交代				2004年 量産開始 (16Mbから)
	0.11μm Advanced				✓ (3V品)	✓	✓	✓	✓	2013年 量産開始 (4Mbから)
A社 LP-SRAM	90nm CMOS, ECC無し	EOL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90nmプロセス製品 (注)
	65nm CMOS ECC内蔵				✓	✓	✓	✓	✓	65nmプロセス製品 (注)
B社 LP-SRAM	CMOS, ECC無し	✓	✓	✓	✓	✓	✓			32Mb以上の製品無し (注)
	CMOS, ECC内蔵				✓	✓				16Mb以上の製品無し (注)

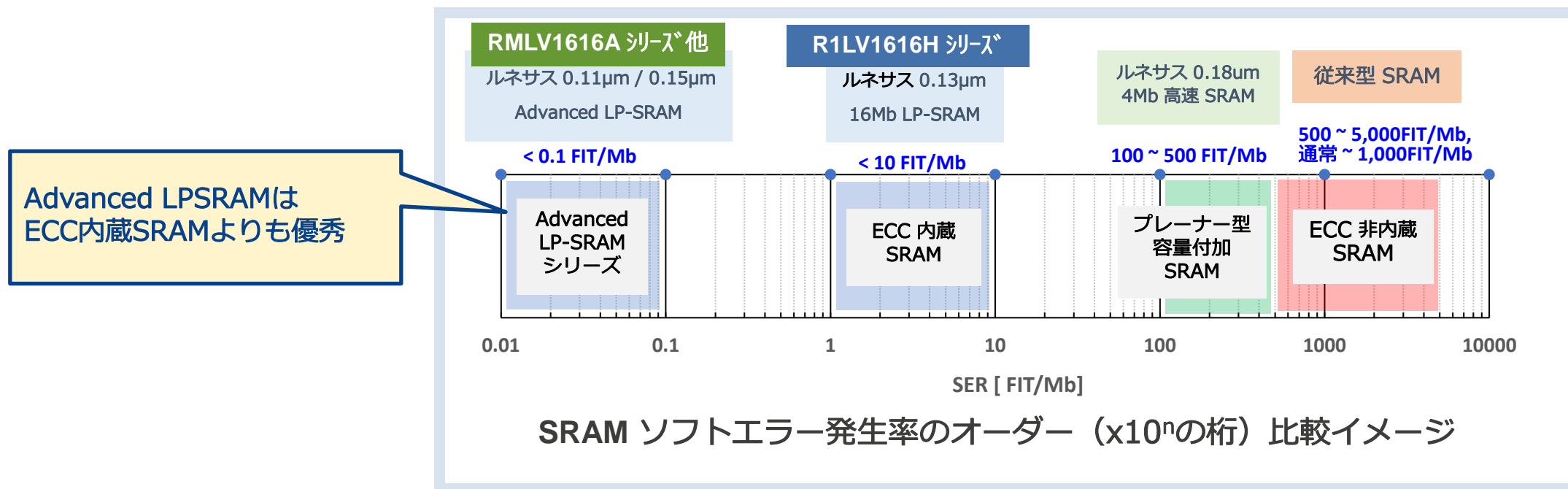
(注) 一般公開情報や営業情報等に基づくルネサスの認識。
他社殿の公式アナウンス情報ではありません。

ECC: Error Correction Code, or Error Checking and Correction

技術比較 ソフトウェアエラー対策

製品シリーズ	ECCを内蔵しているか?	ソフトウェアエラー対策済みか?	具体的手段?	ソフトウェア発生率 (実測値)	特長・優位性
Advanced LPSRAM シリーズ (0.11μm / 0.15μm)	NO	YES	独自技術による臨界電荷量(Qcrit)の増加	< 0.04 FIT/Mb [0.11μm] < 0.06 FIT/Mb [0.15μm]	ECC内蔵製品をも上まわる、卓越したソフトウェアエラー耐性
(EOL品) R1LV1616Hシリーズ (0.13μm CMOS 16Mb)	YES	YES	ECC内蔵	< 5.5 FIT/Mb	1桁 FIT/Mb以下：産業用途としての実用上、優れたソフトウェアエラー耐性

(注) 臨界電荷量 (Qcrit) : ビット反転を起こさせるのに必要な最小の電荷量



プロセス・デバイス技術 Advanced LPSRAMとは

- ルネサス独自技術により、高信頼性と低スタンバイ電流を両立させた低消費電力SRAM
- 記憶ノードにDRAM相当のキャパシタを付加することで ソフトエラー耐性を向上
ECC内蔵無しでソフトエラーフリー（実力値）を達成！
- ロードTr.をTFTとすることで Si基板内に寄生サイリスタ(PNPN構造)を作らず ラッチアップフリー

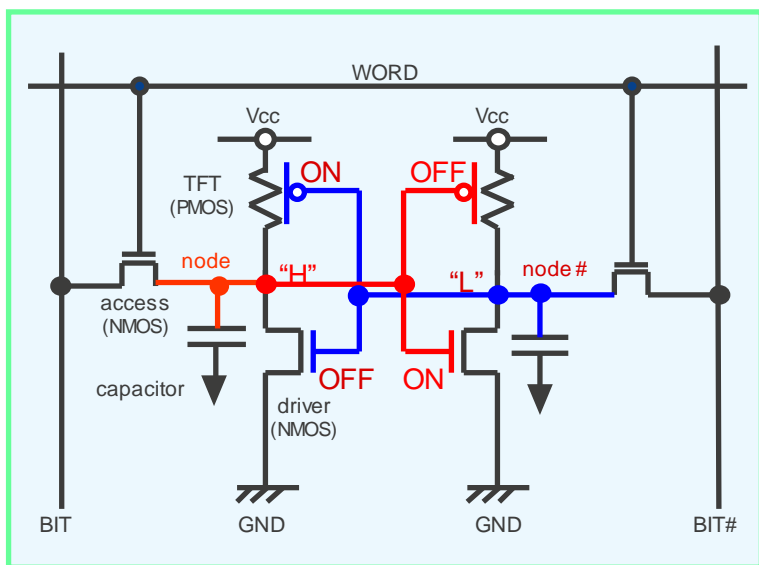


図1. Advanced SRAM等価回路

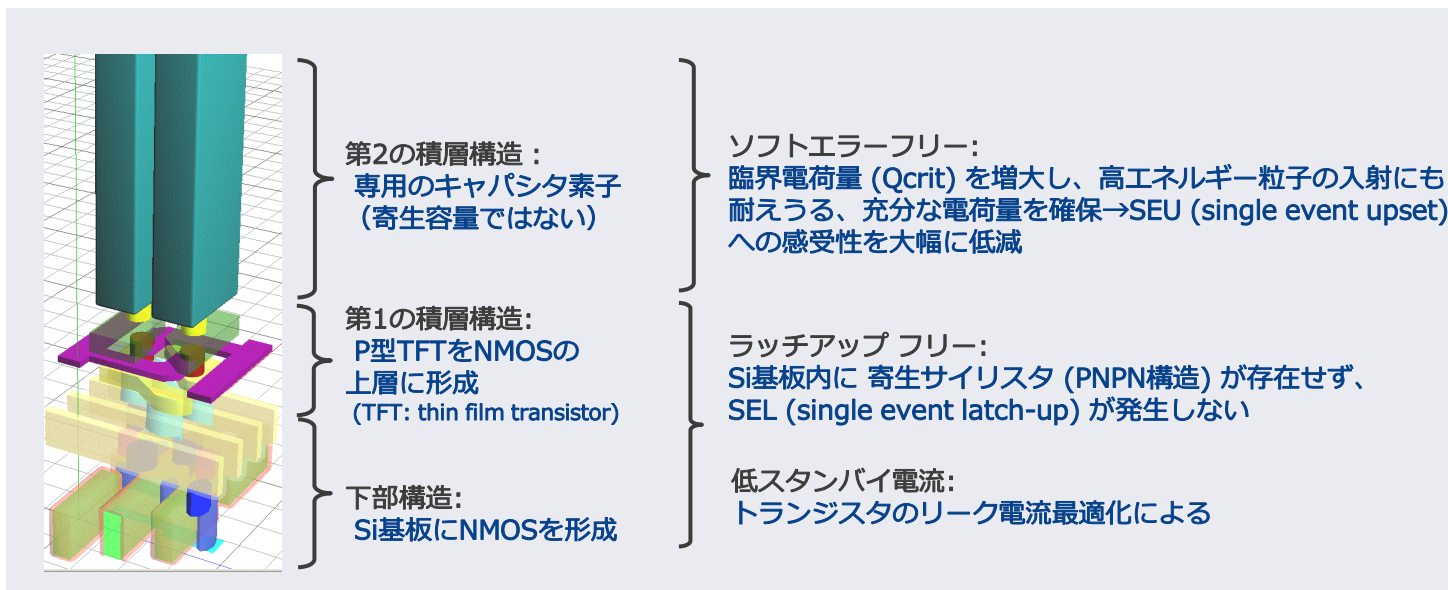
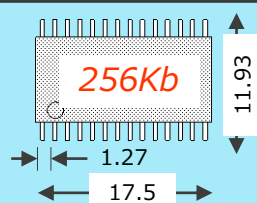
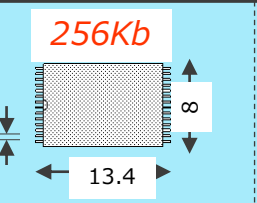
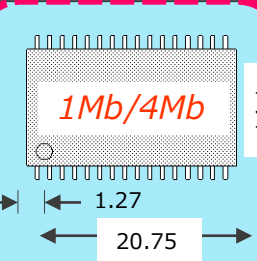
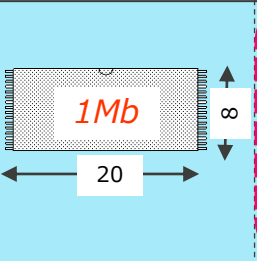
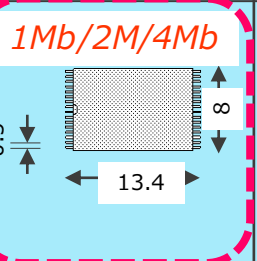
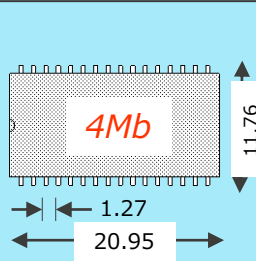
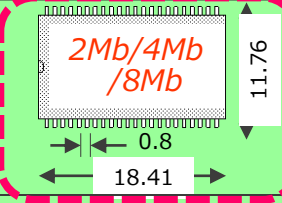
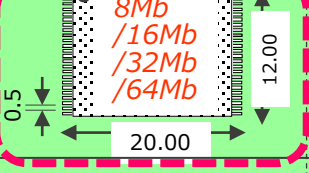
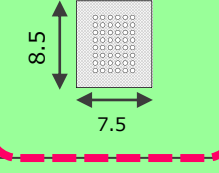
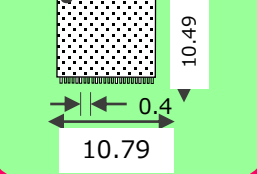


図2. Advanced LPSRAM メモリセル 3Dイメージ

低消費電力SRAM パッケージラインアップ


	SOP	TSOP-I	sTSOP	TSOP-II	μTSOP	FBGA
28pin	 256Kb 11.93 1.27 17.5	 256Kb 0.55 13.4 8				
32pin	 1Mb/4Mb 14.1 1.27 20.75	 1Mb 0.5 20 8	 1Mb/2M/4Mb 0.5 13.4 8	 4Mb 1.27 20.95 11.76		
44pin				 2Mb/4Mb / 8Mb 0.8 18.41 11.76	x8 / x16 Config.	4Mb / 8Mb / 16Mb / 32Mb / 64Mb
48pin (48ball)		 8Mb / 16Mb / 32Mb / 64Mb 0.5 20.00 12.00			8Mb / 16Mb / 32Mb / 64Mb	 8.5 7.5
52pin	ルネサスは上位互換性のあるパッケージを6種類提供しており、プリント基板を変更することなくメモリ容量を拡張することができます。				 10.49 0.4 10.79	

製品ラインアップ 低消費電力SRAM (256Kb ~ 4Mb)

Product Series	Density	Org.	Operating Voltage	Access Time	Standby Current (typ.)	Operating Temperature	Chip Select Option	Package				Mass Production	PLP
								TSOP	SOP	FBGA	μTSOP		
R1LP5256E	256 Kb	x8	4.5 ~ 5.5V	55	0.6 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓			Now	Dec. 2032
R1LP0108E	1 Mb	x8	4.5 ~ 5.5V	55	0.6 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓	✓			Now	Dec. 2032 *Mar. 2031
R1LP0408D	4Mb	x8	4.5 ~ 5.5V	55	0.8 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓			Now	Dec. 2032 *Mar. 2031
R1LV5256E	256 Kb	x8	2.7 ~ 3.6V	55	0.6 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓			Now	Dec. 2032
R1LV0108E	1 Mb	x8	2.7 ~ 3.6V	55	0.6 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓	✓			Now	Dec. 2032 *Mar. 2031
R1LV0208BSA	2 Mb	x8	2.7 ~ 3.6V	55	1 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓				Now	Dec. 2032
R1LV0216BSB	2 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	55	1 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓				Now	Dec. 2032
RMLV0408E	4 Mb	x8	2.7 ~ 3.6V	45	0.3 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓			Now	Dec. 2032 *Mar. 2031
RMLV0414E	4 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	45	0.3 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓				Now	Dec. 2032
RMLV0416E	4 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	45	0.3 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓		✓		Now	Dec. 2032

* TSOP-I (32)とTSOP-II (32)については、2031/3月

※各製品の発注型名（製品仕様+梱包仕様を指定）は、当社Webにてご確認ください


 [低消費電力SRAM | Renesas](#)

製品ラインアップ 低消費電力SRAM (8Mb ~ 64Mb)

Product Series	Density	Org.	Operating Voltage	Access Time	Standby Current (typ.)	Operating Temperature	Chip Select Option	Package				Mass Production	PLP
								TSOP	SOP	FBGA	μTSOP		
RMLV0808BGSB	8 Mb	x8	2.4 ~ 3.6V	45ns	0.45 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓				Now	Dec. 2032
RMLV0816BGBG	8 Mb	x16	2.4 ~ 3.6V	45ns	0.45 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2			✓		Now	Dec. 2032
RMLV0816BGSA	8 Mb	x16	2.4 ~ 3.6V	45ns	0.45 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓				Now	Dec. 2032
RMLV0816BGSB	8 Mb	x16	2.4 ~ 3.6V	45ns	0.45 μA	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓				Now	Dec. 2032
RMLV0816BGSD	8 Mb	x16	2.4 ~ 3.6V	45ns	0.45 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2				✓	Now	Dec. 2032
RMLV1616A-S	16 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	55ns	0.5 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓		✓	✓	Now	Dec. 2032
RMLV1616A-U	16 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	45ns, 55ns	0.4 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓		✓		Now	Dec. 2032 予定 (注)
RMLV3216A	32 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	55ns	0.6 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓		✓	✓	Now	Dec. 2032
RMWV3216A	32 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	55ns	1 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2			✓		Now	Dec. 2032
RMWV6416A	64 Mb	x16	2.7 ~ 3.6V	55ns	1.2 μA	-40°C ~ 85°C	2: CS1#, CS2	✓		✓	✓	Now	Dec. 2032

注：RMLV1616A-Uシリーズは、他製品と同じPLP適用期間を登録予定です。

※各製品の発注型名（製品仕様+梱包仕様を指定）は、当社Webにてご確認ください

 [低消費電力SRAM | Renesas](#)

製品ラインアップ 非同期 高速SRAM (4Mb)

Product Series	Density	Org.	Operating Voltage	Access Time	Standby Current (max.) Std. / L-ver. / S-ver.	Operating Temperature	Chip Select Option	Package		Mass Production	PLP (for TSOP)
								TSOP	SOJ		
R1RP0408D-I	4Mb	x8	4.5 ~ 5.5V	12ns	5mA / - / -	-40°C ~ 85°C	1: CS#		✓	Now	-
R1RP0408D-R	4Mb	x8	4.5 ~ 5.5V	12ns	5mA / 1.0mA / -	0°C ~ 70°C	1: CS#		✓	Now	-
R1RP0416D-I	4Mb	x16	4.5 ~ 5.5V	10ns, 12ns	5mA / - / -	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓	Now	Dec. 2032
R1RP0416D-R	4Mb	x16	4.5 ~ 5.5V	10ns, 12ns	5mA / 1.0mA / 0.5mA	0°C ~ 70°C	1: CS#	✓	✓	Now	Dec. 2032
R1RW0408D-I	4Mb	X8	3.0 ~ 3.6V	12ns	5mA / - / -	-40°C ~ 85°C	1: CS#		✓	Now	-
R1RW0408D-R	4Mb	x8	3.0 ~ 3.6V	12ns	5mA / 0.8mA / -	0°C ~ 70°C	1: CS#		✓	Now	-
R1RW0416D-I	4Mb	x16	3.0 ~ 3.6V	10ns, 12ns	5mA / - / -	-40°C ~ 85°C	1: CS#	✓	✓	Now	Dec. 2032
R1RW0416D-R	4Mb	x16	3.0 ~ 3.6V	10ns, 12ns	5mA / 0.8mA / 0.5mA	0°C ~ 70°C	1: CS#	✓	✓	Now	Dec. 2032

※各製品の発注型名（製品仕様+梱包仕様を指定）は、当社Webにてご確認ください



[非同期SRAM | Renesas](#)

低消費電力SRAM 発注型名

R1 L V 5256 E SA - 5 S I #B1

R1 L P 04 08 D SP - 5 S I #B1

RM L V 04 16 E G SB - 4 S 2 #A A 1

RENESAS Memory

Chip configuration

L	LPSRAM, Single chip
W	LPSRAM, Two chips

Operating Voltage

V	3V
P	5V

Memory Density

5256	256Kb (x8)
01	1Mb
02	2Mb
04	4Mb
08	8Mb
16	16Mb
32	32Mb
64	64Mb

Bus Width

08	x8
16	x16

Chip Generation

Industrial Grade

Package Type

SA	TSOP-I (256Kb/8Mb/16Mb/32Mb/64Mb) sTSOP (1Mb/2Mb/4Mb)
SB	TSOP-II
SD	μTSOP
SF	TSOP-I (1Mb)
SP	SOP (256Kb, 4Mb)
SN	SOP (1Mb)
BG	FBGA

Operating Temperature

R	0 ~ 70°C
I	-40 ~ 85°C
2	-40 ~ 85°C

Packing

A	Tray
C	Magazine
H	Tape & Reel (TSOP-II, μTSOP, SOP)
K	Tape & Reel (FBGA, TSOP-I, sTSOP)

Access time

5	55 ns
4	45 ns

Stand-by current / Data retention current

S	Low power version
U	Ultra Low power version

Packing, Environmental

	Packing	Environmental
#B0 / #B1	Tray or Magazine	Pb free
#S0 / #S1	Tape & Reel	Pb free

Assembly Site Rev. , etc.

Environment

A	Pb free (pure-Tin plating)
C	Pb free (non-pure-Tin plating)

0	Rev. Code
1	Rev. Code

高速 4Mb SRAM 発注型名

R1 R W 04 16 D SB - 2 P I #D1

RENESAS Memory

Fast SRAM

Operation Voltage

W	3.3V
P	5V

Memory density

04	4Mb
----	-----

Bus Width

08	x8
16	x16

Chip generation

Packing, Environmental

	Packing	Environmental
#B0 / #B1	Magazine (SOJ)	Pb free
#D0 / #D1	Tray (TSOP)	Pb free
#S0 / #S1	Tape & Reel	Pb free

Operating Temperature

R	0 ~ 70°C
I	-40 ~ 85°C

Stand by current / Data retention current

P	Standard
L	Low power version
S	Super Low power version

Access time

2	12 ns
0	10 ns

Package type

GE	SOJ
SB	TSOP-II

[Renesas.com](https://www.renesas.com)